



Sun SPARC™ Enterprise T1000 Server Site Planning Guide

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 820-0017-10
April 2007, Revision A

Submit comments about this document at: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

FUJITSU LIMITED provided technical input and review on portions of this material.

Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited each own or control intellectual property rights relating to products and technology described in this document, and such products, technology and this document are protected by copyright laws, patents and other intellectual property laws and international treaties. The intellectual property rights of Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited in such products, technology and this document include, without limitation, one or more of the United States patents listed at <http://www.sun.com/patents> and one or more additional patents or patent applications in the United States or other countries.

This document and the product and technology to which it pertains are distributed under licenses restricting their use, copying, distribution, and decompilation. No part of such product or technology, or of this document, may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Fujitsu Limited and Sun Microsystems, Inc., and their applicable licensors, if any. The furnishing of this document to you does not give you any rights or licenses, express or implied, with respect to the product or technology to which it pertains, and this document does not contain or represent any commitment of any kind on the part of Fujitsu Limited or Sun Microsystems, Inc., or any affiliate of either of them.

This document and the product and technology described in this document may incorporate third-party intellectual property copyrighted by and/or licensed from Fujitsu Limited and Sun Microsystems, Inc., including software and font technology.

Per the terms of the GPL or LGPL, a copy of the source code governed by the GPL or LGPL, as applicable, is available upon request by the End User. Please contact Fujitsu Limited or Sun Microsystems, Inc.

This distribution may include materials developed by third parties.

Parts of the product may be derived from Berkeley BSD systems, licensed from the University of California. UNIX is a registered trademark in the U.S. and in other countries, exclusively licensed through X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve, CoolThreads, J2EE, and Sun are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Fujitsu and the Fujitsu logo are registered trademarks of Fujitsu Limited.

All SPARC trademarks are used under license and are registered trademarks of SPARC International, Inc. in the U.S. and other countries. Products bearing SPARC trademarks are based upon architecture developed by Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 is a trademark of SPARC International, Inc., used under license by Fujitsu Microelectronics, Inc. and Fujitsu Limited.

The OPEN LOOK and Sun™ Graphical User Interface was developed by Sun Microsystems, Inc. for its users and licensees. Sun acknowledges the pioneering efforts of Xerox in researching and developing the concept of visual or graphical user interfaces for the computer industry. Sun holds a non-exclusive license from Xerox to the Xerox Graphical User Interface, which license also covers Sun's licensees who implement OPEN LOOK GUIs and otherwise comply with Sun's written license agreements.

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.

Disclaimer: The only warranties granted by Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. or any affiliate of either of them in connection with this document or any product or technology described herein are those expressly set forth in the license agreement pursuant to which the product or technology is provided. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN SUCH AGREEMENT, FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. AND THEIR AFFILIATES MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND (EXPRESS OR IMPLIED) REGARDING SUCH PRODUCT OR TECHNOLOGY OR THIS DOCUMENT, WHICH ARE ALL PROVIDED AS IS, AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID. Unless otherwise expressly set forth in such agreement, to the extent allowed by applicable law, in no event shall Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. or any of their affiliates have any liability to any third party under any legal theory for any loss of revenues or profits, loss of use or data, or business interruptions, or for any indirect, special, incidental or consequential damages, even if advised of the possibility of such damages.

DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.



Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, Etats-Unis. Tous droits réservés.

Entrée et revue tecnica fournies par FUJITSU LIMITED sur des parties de ce matériel.

Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited détiennent et contrôlent toutes deux des droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits et technologies décrits dans ce document. De même, ces produits, technologies et ce document sont protégés par des lois sur le copyright, des brevets, d'autres lois sur la propriété intellectuelle et des traités internationaux. Les droits de propriété intellectuelle de Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited concernant ces produits, ces technologies et ce document comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, un ou plusieurs brevets déposés aux États-Unis et indiqués à l'adresse <http://www.sun.com/patents> de même qu'un ou plusieurs brevets ou applications brevetées supplémentaires aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document, le produit et les technologies afférents sont exclusivement distribués avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit, de ces technologies ou de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fujitsu Limited et de Sun Microsystems, Inc., et de leurs éventuels bailleurs de licence. Ce document, bien qu'il vous ait été fourni, ne vous confère aucun droit et aucune licence, expresses ou tacites, concernant le produit ou la technologie auxquels il se rapporte. Par ailleurs, il ne contient ni ne représente aucun engagement, de quelque type que ce soit, de la part de Fujitsu Limited ou de Sun Microsystems, Inc., ou des sociétés affiliées.

Ce document, et le produit et les technologies qu'il décrit, peuvent inclure des droits de propriété intellectuelle de parties tierces protégés par copyright et/ou cédés sous licence par des fournisseurs à Fujitsu Limited et/ou Sun Microsystems, Inc., y compris des logiciels et des technologies relatives aux polices de caractères.

Par limites du GPL ou du LGPL, une copie du code source régi par le GPL ou LGPL, comme applicable, est sur demande vers la fin utilisateur disponible; veuillez contacter Fujitsu Limited ou Sun Microsystems, Inc.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces parties.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve, CoolThreads, J2EE, et Sun sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fujitsu et le logo Fujitsu sont des marques déposées de Fujitsu Limited.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 est une marques déposée de SPARC International, Inc., utilisée sous le permis par Fujitsu Microelectronics, Inc. et Fujitsu Limited.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Droits du gouvernement américain - logiciel commercial. Les utilisateurs du gouvernement américain sont soumis aux contrats de licence standard de Sun Microsystems, Inc. et de Fujitsu Limited ainsi qu'aux clauses applicables stipulées dans le FAR et ses suppléments.

Avis de non-responsabilité: les seules garanties octroyées par Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou toute société affiliée de l'une ou l'autre entité en rapport avec ce document ou tout produit ou toute technologie décrit(e) dans les présentes correspondent aux garanties expressément stipulées dans le contrat de licence régissant le produit ou la technologie fourni(e). SAUF MENTION CONTRAIRE EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS CE CONTRAT, FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. ET LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES REJETTENT TOUTE REPRÉSENTATION OU TOUTE GARANTIE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE (EXPRESSE OU IMPLICITE) CONCERNANT CE PRODUIT, CETTE TECHNOLOGIE OU CE DOCUMENT, LESQUELS SONT FOURNIS EN L'ÉTAT. EN OUTRE, TOUTES LES CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, SONT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE. Sauf mention contraire expressément stipulée dans ce contrat, dans la mesure autorisée par la loi applicable, en aucun cas Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou l'une de leurs filiales ne sauraient être tenues responsables envers une quelconque partie tierce, sous quelque théorie juridique que ce soit, de tout manque à gagner ou de perte de profit, de problèmes d'utilisation ou de perte de données, ou d'interruptions d'activités, ou de tout dommage indirect, spécial, secondaire ou consécutif, même si ces entités ont été préalablement informées d'une telle éventualité.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ÉTAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

Contents

Sun SPARC Enterprise T1000 Server Site Planning Guide	1
Physical Specifications	2
Minimum Clearance for Service Access	2
Environmental Specifications	3
Power Source Requirements	4
Acoustic Noise Emissions	4
Agency Compliance Specifications	4
General Site Preparation Notes	5
Ambient Temperature	5
Ambient Relative Humidity	5
Airflow Considerations	6

Sun SPARC Enterprise T1000 Server Site Planning Guide

This guide provides the specifications and site requirements you need when planning the installation of the Sun SPARC Enterprise T1000 server.

For safety and compliance information, refer to the *Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide* and the *Important Safety Information for Sun Hardware Systems* document that came with your server.

This guide contains the following sections:

- [“Physical Specifications” on page 2](#)
- [“Minimum Clearance for Service Access” on page 2](#)
- [“Environmental Specifications” on page 3](#)
- [“Power Source Requirements” on page 4](#)
- [“Acoustic Noise Emissions” on page 4](#)
- [“Agency Compliance Specifications” on page 4](#)
- [“General Site Preparation Notes” on page 5](#)

Physical Specifications

Description	U.S.	Metric
Width	16.8 in.	425 mm
Depth	18.4 in.	467 mm
Height	1.75 in., 1 rack unit	43 mm
Weight (without PCI card and rackmounts)	20.5 lb	9.3 kg
Weight (with slide rails)	24 lb	10.9 kg

Minimum Clearance for Service Access

These are the minimum clearances needed for service.

Description	Specification
Clearance, front of system	36 in. (91 cm)
Clearance, rear of system	36 in. (91 cm)

Environmental Specifications

Specification	Operating	Non-operating
Operating temperature:		
<ul style="list-style-type: none"> Sea level to 3000 ft (900m) Above 3000 ft (900m) 	<ul style="list-style-type: none"> 41°F to 95°F (5°C to 35°C) Decrease maximum temperature as altitude increases, 1.6°F/1000 ft (1°C/300m) 	<ul style="list-style-type: none"> -40 to 60°C -40 to 60°C
Humidity	20 to 80% RH, non-condensing, 27°C wet bulb, IEC 60068-2-3&56	98% RH 38°C, non-condensing, IEC 60068-2-3&56
Altitude	0-3,000 meters (0-10,000 feet) IEC 60068-2-13	0 - 12,000 meters (0-40,000 feet) IEC 60068-2-13
Vibration	0.2 Gs, Swept sine 5-500-5Hz, 1 octave/min, all axes, IEC 60068-2-13	1.0 Gs, Swept sine 5-500-5Hz, 1 octave/min, all axes, IEC 60068-2-13
Shock	5 Gs peak 11 milliseconds, half-sine pulse, IEC 60068-2-27	30 Gs peak 11 milliseconds, half-sine pulse, IEC 60068-2-27

Power Source Requirements

The Sun SPARC Enterprise T1000 server has an autoranging power supply.

Description	Specification
Operating input voltage range	100 to 240 VAC, 50-60 Hz (Input voltage tolerance $\pm 10\%$)
Maximum operating input current	2.2 A at 100 to 120 VAC 1.1 A at 200 to 240 VAC
Typical operating input power	180 W
Maximum operating input power	220 W
Typical heat dissipation	614 BTU/hr. (647 KJ/hr)
Maximum heat dissipation	750 BTU/hr. (791 KJ/hr)

Acoustic Noise Emissions

Declared noise emissions are in accordance with ISO 9296 standards.

Description	Mode	Specification
LwAd (1 B = 10 dB)	Operating acoustic noise	7.7 B
	Idling acoustic noise	7.7 B
LpAm (bystander positions)	Operating acoustic noise	66 dB
	Idling acoustic noise	66 dB

Agency Compliance Specifications

See the *Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide* for a full list of agency compliance specifications.

General Site Preparation Notes

Your environmental control system must provide intake air for the server that complies with the limits specified in [“Environmental Specifications” on page 3](#).

To avoid overheating, *do not* direct warmed air:

- Toward the front air intake of the server
- Toward the server access panels

Note – When you receive your server, place it in the environment in which you will install it. Leave in its shipping crate at its final destination for 24 hours. This resting period prevents thermal shock and condensation.

The server has been tested to meet all functional requirements when operating in the operating environmental limits presented in [“Environmental Specifications” on page 3](#). Operating computer equipment in extremes of temperature or humidity increases the failure rate of hardware components. To minimize the chance of component failure, use the server within the optimal temperature and humidity ranges.

Ambient Temperature

An ambient temperature range of 69.8°F (21°C) to 73.4°F (23°C) is optimal for system reliability. At 71.6°F (22°C) it is easy to maintain safe relative humidity levels. Operating in this temperature range provides a buffer if the environmental support systems fail.

Ambient Relative Humidity

Ambient relative humidity levels between 45% and 50% are the most suitable for data processing operations in order to:

- Prevent corrosion
- Provide an operating time buffer in the event of environmental control system failure
- Help avoid failures caused by the intermittent interference from static discharges that occur when relative humidity is too low

Electrostatic discharge (ESD) is easily generated and less easily dissipated in areas where the relative humidity is below 35%, and becomes critical when levels drop below 30%.

Airflow Considerations

- Ensure unobstructed airflow through the chassis.
- Ensure that inlet air enters at the front of the server and exits from the back.
- Ensure that ventilation openings such as cabinet doors, for both the inlet and exhaust of the server provide a minimum open area of 33.3 in.² (215 cm²) each. This equates to a 60% open area perforation pattern across the front (17.5 in. x 3.2 in.) and rear area of the server (445 mm x 81 mm). The impact of other open area characteristics that are more restrictive should be evaluated by the user.
- Allow a minimum of 0.2 in. (5 mm) clearance at the front of the system and 3.1 in. (80 mm) at the rear of the server when mounted. These clearance values are based on the inlet and exhaust impedance (available open area), and assume a uniform distribution of the open area across the inlet and exhaust areas. Clearance values greater than these might improve cooling performance.

Note – The combination of inlet and exhaust restrictions such as cabinet doors and the spacing of the server from the doors can affect the cooling performance of the server and should be evaluated by the user.

- Take care to prevent recirculation of exhaust air within a rack or cabinet.
- Manage cables to minimize interference with the server exhaust vent.
- Ensure that air temperature rise through the system is approximately 59°F (15°C).